

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 33, DE 23 DE MAIO DE 2017

Estabelece o Processo Produtivo Básico para os produtos TELEJOGOS E SEUS ACESSÓRIOS (“JOYSTICKS”) e CARTUCHO PARA TELEJOGOS, industrializados na Zona Franca de Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e considerando o que consta no processo MDIC nº 52001.001678/2016-79, de 27 de outubro de 2016, resolvem:

Art. 1º Até 31 de dezembro de 2016, o Processo Produtivo Básico para os produtos TELEJOGOS E SEUS ACESSÓRIOS (“JOYSTICKS”) e CARTUCHOS PARA TELEJOGOS, industrializados na Zona Franca de Manaus estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 102, de 16 de abril de 2015, passa a ser o seguinte:

- I - montagem e soldagem de todos os componentes na placa do disco rígido (HDD - Hard Disk Drive), quando aplicável;
- II - encapsulamento da unidade de disco rígido, por meio da montagem mecânica e soldagem das tampas do gabinete que a envolve, quando aplicável;
- III - fabricação do gabinete do telejogo (tampa superior e inferior) a partir da injeção plástica, quando aplicável;
- IV - fabricação dos chicotes elétricos (feixe de fios com seus conectores) não sobreinjetados, a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre;
- V - fabricação dos cabos de força para corrente alternada, mesmo sobreinjetados, fabricados a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre;
- VI - fabricação dos circuitos impressos (placa nua) da placa mãe;
- VII - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas do Módulo Wi-Fi, quando aplicável;
- VIII - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso com componentes ou circuito integrado ou módulos que implementem a função de memória, do tipo DRAM ou NAND Flash, quando aplicável;
- IX - fabricação da unidade de armazenamento de dados, não volátil em meio semicondutor (SSD - Solid State Drive), quando aplicável;
- X - fabricação da fonte de alimentação (conversor CA/CC) ou gabinete metálico (chassi);
- XI - montagem e soldagem de todos os componentes na placa principal;
- XII - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e

XIII - integração das placas e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.

§ 1º Todas as etapas descritas no caput deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus, exceto as etapas descritas nos incisos VI, VII, VIII e IX, que poderão ser realizadas em outras regiões do País.

§ 2º Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, exceto a etapa descrita no inciso XIII do caput, que não poderá ser objeto de terceirização.

§ 3º O cumprimento das etapas previstas nos incisos I a X do caput deste artigo deverá observar o disposto no art. 4º.

Art. 2º Fica dispensado o cumprimento da etapa estabelecida no inciso XI do art. 1º até o limite de 18% (dezoito por cento) da quantidade total de placas montadas, a ser utilizada pela empresa na fabricação do produto, conforme produção no ano-calendário.

Parágrafo único. No caso de início de produção, a partir do segundo semestre do ano-calendário, o cumprimento do percentual a que se refere o caput poderá ser efetuado até 31 de dezembro do ano subsequente ao em que se verificar o início de produção.

Art. 3º Fica temporariamente dispensada a montagem dos seguintes módulos ou subconjuntos:

- I - subconjunto mecanismo leitor de mídia para telejogos;
- II - dispositivos de entrada de dados e/ou acionamento para controle de telejogos (joysticks e controle remoto), com ou sem sensor de captura de movimento e/ou som;
- III - módulo de comunicação sem fio tecnologia Bluetooth;
- IV - antena interna para rede de comunicação sem fio (rede wireless);
- V - módulo de interface de comunicação sem fio (wireless) do console com o controle de telejogo (joystick);
- VI - subconjuntos mecânicos constituídos de peças plásticas e/ou metálicas, com ou sem fiação elétrica, compostos de, até, 15 (quinze) componentes, exceto quando constituídos de gabinetes (tampa superior e inferior);
- VII - módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi) combinado com tecnologia Bluetooth, sob a forma de circuito integrado híbrido com encapsulamento tipo BGA (Ball Grid Array);
- IX - Unidade Híbrida de armazenamento de dados SSHD (Solid State Hybrid Drives); e
- X - As placas de circuito impresso com componentes ou circuito integrado ou módulo que implemente a função de memória do tipo GDRAM e NOR Flash.

Parágrafo único. As dispensas a que se refere o caput para os dispositivos constantes dos incisos I e II aplicam-se, apenas, à fabricação do produto TELEJOGO.

Art. 4º Os seguintes subconjuntos, partes, peças e componentes deverão ser fabricados, conforme seus respectivos Processos Produtivos Básicos, e de acordo com o

cronograma abaixo, no qual os percentuais são calculados sobre a base total de utilização dos respectivos componentes, no ano calendário:

SUBCONJUNTOS, PARTES, PEÇAS E COMPONENTES	2013	2014	2015	2016
I - Gabinete do telejogo (tampa superior e inferior) a partir da injeção plástica.	-	50%	80%	80%
II - Chicotes elétricos (feixe de fios com seus conectores) não sobreinjetados, fabricados a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre.	50%	60%	80%	80%
III - Cabos de força para corrente alternada, mesmo sobreinjetados, fabricados a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre, observado o disposto no §1º deste artigo.				
IV - Circuitos impressos (placa nua) da placa mãe.	-	-	20%	10%
V - Módulo Wi-Fi	-	30%	40%	50%
VI - Placa de circuito impresso com componentes ou circuito integrado ou módulos que implementem a função de memória, do tipo DRAM ou NAND Flash, quando aplicável.	-	30%	40%	50%
VII - Unidade de armazenamento de dados, não volátil em meio semiconductor (SSD - Solid State Drive), quando aplicável.	-	30%	40%	50%
VIII - Fonte de alimentação (conversor CA/CC) ou gabinete metálico (chassi)	-	50%	60%	60%
IX - Unidade magnética de disco rígido (HDD)	-	-	60%	80%

§ 1º Os cabos de força para corrente alternada aos quais se refere o inciso III do cronograma estabelecido no caput deste artigo deverão ser fabricados a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre, de acordo com o percentual mínimo de 90% (noventa por cento), em peso, tomando por base a quantidade total utilizada na produção, no ano calendário.

§ 2º Caso os percentuais estabelecidos neste artigo não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano subsequente, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 3º A diferença residual a que se refere o § 2º não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não for possível atingir o limite estabelecido.

§ 4º A fonte de alimentação (conversor CA/CC) a que se refere este artigo deverá ser fabricada a partir da montagem dos componentes na placa de circuito impresso e adição do cabo de força fabricado de acordo com o disposto no inciso III e no § 1º.

§ 5º Os percentuais de utilização de fontes de alimentação (conversores CA/CC) ou gabinetes metálicos (chassis), para fins de cumprimento do inciso VIII do cronograma estabelecido no caput deste artigo, podem ser contabilizados de forma isolada ou cumulativa.

§ 6º Excepcionalmente, o percentual de 50% (cinquenta por cento) estabelecido pelo inciso I do caput para a fabricação dos gabinetes do telejogo a partir da injeção plástica, com relação ao ano de 2014, poderá ultrapassar o percentual disposto no § 3º e ser compensado, em quantidade, pelas empresas, até 31 de dezembro de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 7º Excepcionalmente, o percentual de 50% (cinquenta por cento) estabelecido pelo inciso II do caput para a fabricação de chicotes elétricos, com relação ao ano de 2013, poderá ser compensado, em quantidade, pelas empresas, até 31 de dezembro de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 8º Excepcionalmente, o percentual de 30% (trinta por cento) estabelecido pelo inciso V do caput para a fabricação de módulos

Wi-Fi do telejogo, com relação ao ano de 2014, poderá ultrapassar o percentual disposto no § 3º e ser compensado, em quantidade, pelas empresas, até 31 de dezembro de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 9º Excepcionalmente, o percentual de 50% (cinquenta por cento) estabelecido pelo inciso VIII do caput para a fabricação da fonte de alimentação ou gabinete metálico, com relação ao ano de 2014, poderá ultrapassar o percentual disposto no § 3º e ser compensado, em quantidade, pelas empresas, até 31 de dezembro de 2016, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 10. Excepcionalmente, o percentual de 80% (oitenta por cento) estabelecido pelo inciso I deste artigo para a fabricação de gabinete do telejogo (tampa superior e inferior) a partir da injeção plástica, com relação a 2015, poderá ser compensado em quantidade pela empresa até 31 de dezembro de 2018, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 11. Excepcionalmente, o percentual de 80% (oitenta por cento) estabelecido pelo inciso II do caput para a fabricação de chicotes elétricos, com relação a 2015, poderá ser compensado em quantidade pela empresa até 31 de dezembro de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 12. Excepcionalmente, o percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo inciso IV do caput deste artigo para a fabricação dos circuitos impressos (placa nua) da placa mãe, com relação a 2015, poderá ser compensado em quantidade pela empresa até 31 de dezembro de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 13. Excepcionalmente, o percentual de 40% (quarenta por cento) estabelecido pelo inciso V do caput para a fabricação de módulos WI-FI, com relação a 2015, poderá ser compensado em quantidade pela empresa até 31 de dezembro de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 14. Excepcionalmente, o percentual de 40% (quarenta por cento) estabelecido pelo inciso VI do caput deste artigo para a fabricação de placa de circuito impresso com componentes ou circuito integrado

ou módulos que implementem a função de memória, do tipo DRAM ou NAND Flash, quando aplicável, com relação a 2015, poderá ser compensado em quantidade, pelas empresas, até 31 de dezembro de 2017, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 15. Excepcionalmente, o percentual de 60% (sessenta por cento) estabelecido pelo inciso VIII do caput deste artigo para a fabricação de fonte de alimentação (conversor CA/CC) e/ou gabinete metálico (chassi), com relação a 2015, poderá ser compensado em quantidade, pelas empresas, até 31 de dezembro de 2018, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 16. Para fazer uso das excepcionalidades tratadas nos §§ 10, 11, 13 e 15 a empresa deverá investir 0,1% (um décimo por cento) de seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização dos bens incentivados, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, para cada excepcionalidade utilizada.

Art. 5º Alternativamente às regras estabelecidas nos artigos anteriores, para os anos de 2013 a 2016, excetuando a regra estabelecida no inciso IX do art. 4º que trata da fabricação da unidade magnética de disco rígido (HDD), a empresa poderá investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), por meio da aplicação de 0,45% (quarenta e cinco décimos por cento) sobre o faturamento anual dos respectivos anos, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, para cada item que deixou de atender o percentual exigido, de forma proporcional.

Parágrafo único. O investimento adicional em P&D previsto neste artigo deverá ser realizado, para cada ano de descumprimento, até 31 de março, tendo como data inicial o ano de 2018, para os investimentos relativos aos descumprimentos das obrigações do ano de 2013 e data final 31 de março de 2021.

Art. 6º No caso de empresa que não apresente produção, no ano seguinte, por motivo de encerramento de sua atividade fabril, encerramento de fabricação própria ou comprovação de término de contrato, em caso de fabricante atuando sob contrato de manufatura para terceiros, a empresa poderá repassar as obrigações de que tratam os §§ 5º a 16 do art. 4º à empresa sucessora do contrato, ou à empresa contratada para a manufatura do produto, desde que com a anuência desta.

Art. 7º A partir de 1º de janeiro de 2017, o Processo Produtivo Básico para os produtos TELEJOGOS E SEUS ACESSÓRIOS (“JOYSTICKS”) e CARTUCHOS PARA TELEJOGOS, passa a ser o seguinte:

I - montagem e soldagem de todos os componentes na placa principal;

II - montagem e soldagem de todos os componentes na placa do disco rígido (HDD - Hard Disk Drive), quando aplicável;

III - injeção plástica da tampa superior e inferior do gabinete do telejogo, quando aplicável.

IV - trefilação e recozimento do fio de cobre dos chicotes elétricos (feixe de fios com seus conectores) não sobre injetados.

V - trefilação e recozimento do fio de cobre dos cabos de força para corrente alternada, mesmo sobre injetados.

VI - encapsulamento dos circuitos integrados utilizados em módulos ou de forma individual que implementem a função de memória, do tipo NAND Flash, quando aplicável.

VII - encapsulamento dos circuitos integrados utilizados em módulos ou de forma individual que implementem função de memória, do tipo DRAM, quando aplicável; e

VIII - montagem e soldagem de todos os componentes na placa do Solid State Drive (SSD) conforme seu PPB específico, quando aplicável;

IX - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes;

X - integração das placas e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final.

§ 1º Todas as etapas descritas deverão ser realizadas na Zona Franca de Manaus, exceto as etapas descritas nos incisos VI, VII e VIII que poderão ser realizadas em outras regiões do País.

§ 2º Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, exceto a etapa descrita no inciso X, que não poderá ser objeto de terceirização.

§ 3º O cumprimento das etapas previstas nos incisos II a VI, VII e VIII do caput deverá observar o disposto no art. 9º desta Portaria.

§ 4º Fica dispensado o cumprimento da etapa estabelecida no inciso I até o limite de 18% (dezoito por cento) da quantidade total de placas montadas, a ser utilizada pela empresa na fabricação do produto, conforme produção no ano-calendário.

§ 5º No caso de início de produção, a partir do segundo semestre do ano-calendário, o cumprimento das etapas produtivas desta Portaria, poderão ser efetuados até 31 de dezembro do ano subsequente ao em que se verificar o início de produção.

Art. 8º Fica temporariamente dispensada a montagem dos seguintes módulos ou subconjuntos:

I - subconjunto mecanismo leitor de mídia para telejogos;

II - dispositivos de entrada de dados e/ou acionamento para controle de telejogos (joysticks e controle remoto), com ou sem sensor de captura de movimento e/ou som;

III - módulo de comunicação sem fio tecnologia Bluetooth;

IV - antena interna para rede de comunicação sem fio (rede wireless);

V - módulo de interface de comunicação sem fio (wireless) do console com o controle de telejogo (joystick);

VI - subconjuntos mecânicos constituídos de peças plásticas e/ou metálicas, com ou sem fiação elétrica, compostos de, até, 15 (quinze) componentes, exceto quando constituídos de gabinetes (tampa superior e inferior);

- VII - módulo de comunicação sem fio (Wi-Fi) combinado com tecnologia Bluetooth;
- VIII - unidade híbrida de armazenamento de dados SSHD (Solid State Hybrid Drives).
- IX - placas de circuito impresso com componentes ou circuito integrado ou módulo que implemente a função de memória do tipo GDDR e NOR Flash;
- X - módulos de comunicação sem fio (Wi-Fi); e
- XI - fonte de alimentação (conversor CA/CC).

Parágrafo único. As dispensas a que se refere o caput para os dispositivos constantes dos incisos I e II aplicam-se, apenas, à fabricação do produto TELEJOGO.

Art. 9º As etapas a que se refere o caput do art. 7º deverão ser cumpridas de acordo com o cronograma abaixo, no qual os percentuais são calculados sobre a base total de utilização dos respectivos componentes, no ano calendário:

ETAPAS PRODUTIVAS	2017 em diante
I - montagem e soldagem de todos os componentes na placa do disco rígido (HDD - Hard Disk Drive)	80%
II - injeção plástica da tampa superior e inferior do gabinete do telejogo	80%
III - trefilação e recozimento do fio de cobre dos chicotes elétricos (feixe de fios com seus conectores) não sobre injetados, observado o disposto no parágrafo único deste artigo	80%
IV - trefilação e recozimento do fio de cobre dos cabos de força para corrente alternada, mesmo sobre injetados.	80%
V - encapsulamento dos circuitos integrados utilizados em módulos ou de forma individual que implementem a função de memória, do tipo NAND Flash, quando aplicável.	50%
VI- encapsulamento dos circuitos integrados utilizados em módulos ou de forma individual que implementem função de memória, do tipo DRAM, quando aplicável.	50%
VII - Montagem e soldagem de todos os componentes na placa do Solid State Drive (SSD) conforme seu PPB específico, quando aplicável.	50%

Parágrafo único. Os cabos de força para corrente alternada aos quais se refere o inciso III do cronograma estabelecido no caput deste artigo deverão ser fabricados a partir da trefilação e recozimento do fio de cobre, de acordo com o percentual mínimo de 90% (noventa por cento), em peso, tomando por base a quantidade total utilizada na produção, no ano calendário.

Art. 10. Caso os percentuais estabelecidos no art. 9º não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano subsequente, sem prejuízo das obrigações correntes.

Parágrafo único. A diferença residual a que se refere o caput não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não for possível atingir o limite estabelecido

Art. 11. A partir de 1º de janeiro de 2017, alternativamente às obrigatoriedades constantes dos incisos de II a VII do art. 9º desta Portaria, a empresa poderá investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento

(P&D), um percentual de 1% (um por cento) do faturamento anual do ano calendário, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, para cada etapa não cumprida, proporcional ao descumprimento de cada item.

Art. 12. Para efeito da aplicação dos investimentos em P&D, serão considerados como aplicação em pesquisa e desenvolvimento do ano-calendário, os dispêndios correspondentes à execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas até 31 de março do ano subsequente.

Art. 13. A empresa deverá investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), um percentual de 1% (um por cento) do faturamento anual do ano calendário, deduzidos os tributos correspondentes

a tais comercializações, proporcionalmente, para cada etapa não cumprida, caso não apresente produção, por motivo de encerramento de sua atividade fabril, ou comprovação de término de contrato, em caso de fabricante atuando sob contrato de manufatura para terceiros.

Parágrafo único. O investimento adicional em P&D previsto neste artigo poderá ser realizado em até 1 (um) ano após o ano de encerramento da atividade fabril ou do término de contrato referido no caput.

Art. 14. No caso de empresa que não apresente produção, no ano seguinte, por motivo de encerramento de sua atividade fabril, encerramento de fabricação própria ou comprovação de término de contrato, em caso de fabricante atuando sob contrato de manufatura para terceiros, a empresa poderá repassar as obrigações de que trata esta Portaria à empresa sucessora do contrato, ou à empresa contratada para a manufatura do produto, desde que com a anuência desta.

Art. 15. Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 17. Fica revogada a Portaria interministerial MDIC/MCTI nº 102, de 16 de abril de 2015.

**MARCOS PEREIRA**

Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

**GILBERTO KASSAB**

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações